

聯策科技
SynPower

聯策科技股份有限公司

2026 半導體展高峰論壇

2026.09.01

AVOT

免責聲明

本簡報及相關資訊係依據本公司目前可取得之資料、營運狀況及市場環境所編製，內容僅供投資人參考，並非對未來營運成果、財務表現或股價表現之保證。

本簡報中如涉及未來展望、營運方向、產品發展或市場趨勢等前瞻性陳述，可能受到市場需求、產業競爭、政策法令、匯率變動、總體經濟情勢及其他本公司無法掌控因素影響，實際結果可能與預期有所差異。

本公司不提供財務預測，亦不對特定客戶、接單金額、毛利率或尚未公開資訊進行說明。相關財務與營運資訊，仍以本公司依法公告之資訊為準。

本簡報內容未經本公司書面同意，不得任意轉載、引用或作為其他用途。

聯策科技 | 智能製造整合服務

聚焦PCB、半導體載板與先進封裝應用，整合濕製程、檢測與機器視覺設備技術，提供智慧製造解決方案。



成立時間

2002

上市代號

6658

資本額

3.64億元

集團員工

320+

集團子公司

映利科技 

各式水平濕製程設備

碩晶科技 

PCB 表面處理代工服務



桃園總部



映利科技



碩晶科技

主要營運據點與技術服務網絡

貼近客戶需求，提供即時在地服務



4大市場服務網絡



服務據點涵蓋台灣、中國、泰國與印度，提供快速且貼近客戶需求的在地技術支援。

50%+ 工程技術人力占比



超過半數員工投入應用工程、現場服務與客戶技術支援，強化設備導入、製程整合與售後服務能力。

★ 營運中心

🔧 服務據點

🏢 研發中心

🏢 子公司

核心產品與智慧製造解決方案

機器視覺應用



PCB設備

- AOI / AVI 外觀檢查機
- 日本光學檢查設備(在地整合化)
- 載板多功能方向檢查機
- 自動線寬線距量測機

半導體設備

- 自動光學檢測機
- 半導體載具量測機
- 玻璃/矽中介層自動光學檢測機
- 基恩斯自動化方案
- 封裝自動化檢測設備

先進濕製程



PCB設備

- 載板濕製程水平線
- 載板薄鍍鉍金藥水與代工
- 在線藥水分析儀
- 玻璃基板專案開發(工研院合作)
- 不溶性陽極

半導體設備

- 全自動槽式清洗設備
- 全自動單片清洗設備
- 供酸系統
- 蒸氣二流體設備

智能化生產與智慧節能



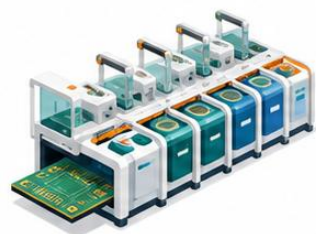
智慧製造

- 影像AI檢測
- 二維碼追溯系統
- AI行為偵測系統
- 廠務智慧化系統
- 數據與影像AI應用

智慧節能

- 低溫節能鼓風機
- 防爆節能集層風機
- 冰水機 (磁懸浮/螺旋式中央空調)
- 中央調控節能系統

以PCB表面處理為基礎，持續向高階載板、新材料與新製程應用升級



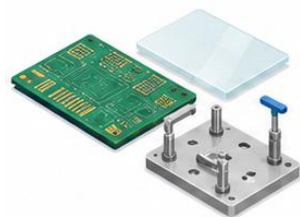
多元製程與量產能力

涵蓋化學鎳金、鎳鉕金、化學銀等表面處理製程，具彈性產線配置與量產能力。

多製程

彈性產線

規模量產



應用延伸與客製能力

應用涵蓋 PCB、載板與玻璃基板，並具專用治具與製程適配能力。

PCB

載板

玻璃基板

專用治具



精密檢測與製程驗證

配置專用 X-ray 膜厚檢測，結合藥水分析與製程驗證，支援高可靠度需求。

X-ray 膜厚檢測

藥水分析

製程檢驗



管理體系與環境治理

ISO 9001、ISO 14001 持續執行，具 IATF 16949 導入經驗，並具無塵檢驗與環境管理能力。

ISO 9001

ISO 14001

Class 10,000

廢水處理

貴金屬回收

未來
成長方向

01



高階載板

提高高階載板與高可靠度產品應用比重。

02



玻璃基板與新材料

布局玻璃基板、新材料及相關表面處理製程。

03



獨立成長與資本市場

提升營運規模與獲利品質，建立長期資本市場發展基礎。

映利科技 | 水平濕製程設備解決方案

以水平濕製程設備為核心，整合設備設計、客製工程與智慧製造能力，持續延伸高階 PCB、IC 載板與半導體相關製程應用。

01 | 水平濕製程設備

涵蓋前後處理、清洗、蝕刻等多類型設備，具設備設計、製造與製程對應能力。



02 | 客製工程與設備升級

依產品與製程需求進行設備模組及功能客製，並具舊線整改、設備升級與製程改善能力。



03 | 製程監控與智慧整合

結合藥水分析、製程監控與智慧製造技術，提升設備管理與製程整合。



應用延伸方向



聯策 × Brooks | 半導體載具檢測國際合作

以 FOUP 智慧檢量測技術為基礎，透過規格共同開發、技術授權與全球商業化，拓展半導體前段設備應用



聯策科技

核心檢測技術

- 光學/視覺檢測
- AI 輔助判讀
- 自動化設備整合
- 晶圓載具量測



研發與技術授權

01 | 共同制定規格

依晶圓廠需求持續優化檢測項目與自動化流程

02 | 技術授權合作

建立長期技術合作關係，推動產品導入與市場拓展

03 | 建立技術壁壘

相關檢測技術取得專利，強化產品差異化與技術門檻

Brooks

全球行銷網路

- 全球半導體客戶基礎
- 銷售與服務網絡
- 設備導入與售後支援
- 全球市場拓展能力

策略合作效益

半導體市場深化

由 PCB / 載板檢測能力，延伸至半導體前段晶圓載具應用

國際客戶拓展

結合 Brooks 全球客戶與服務網絡，增加海外市場導入機會

技術競爭力提升

透過共同規格開發與專利布局，強化產品差異化與技術門檻

玻璃載板 AOI 檢測方案

切入 Glass Core、TGV 與 RDL 等先進封裝應用

Alpha WFI-20



支援玻璃載板 2D / 3D
自動光學檢測與量測

- 自動化上下料，提升**量產檢測效率**
- 高穩定影像擷取，提升**檢測精度**
- 大面積影像拼接，支援**載板完整檢測**
- 多角度成像，提升**微細缺陷檢出能力**

目標應用



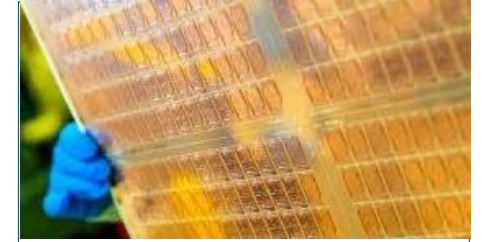
玻璃載板

表面缺陷檢測



玻璃通孔 (TGV)

孔洞幾何與缺陷檢測



重佈線層 (RDL)

線路圖形與缺陷檢測

先進封裝應用

切入 Glass Core /
TGV / RDL 檢測需求

高精度檢測

0.25 $\mu\text{m}/\text{pixel}$ 高
解析影像能力

2D + 3D

兼具缺陷檢測與
尺寸量測

量產導向設計

支援自動化、雙面
與高速檢測

意見交流與討論

Q&A Session

謝謝指導

